

IBM Power System LC922 (9006-22P) クイック・インス トール・ガイド



IBM® Power® System LC922 (9006-22P) クイック・インストー ル・ガイド

IBM Knowledge Center は、http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hdx/9006_22p_landing.htm からオンラインで使用できます。

- 主要な部品に対する作業を開始する前に、予防措置と手順に関するすべての説明をお読みください。
- システムおよび部品に対して作業を行うときは、静電気の放電 (ESD) の正しい手順を使用してください。IBM は、機器に損傷を与えるおそれがないよう、手袋と帯電防止リスト・ストラップを装着することをお勧めしています。

9006-22P の部品

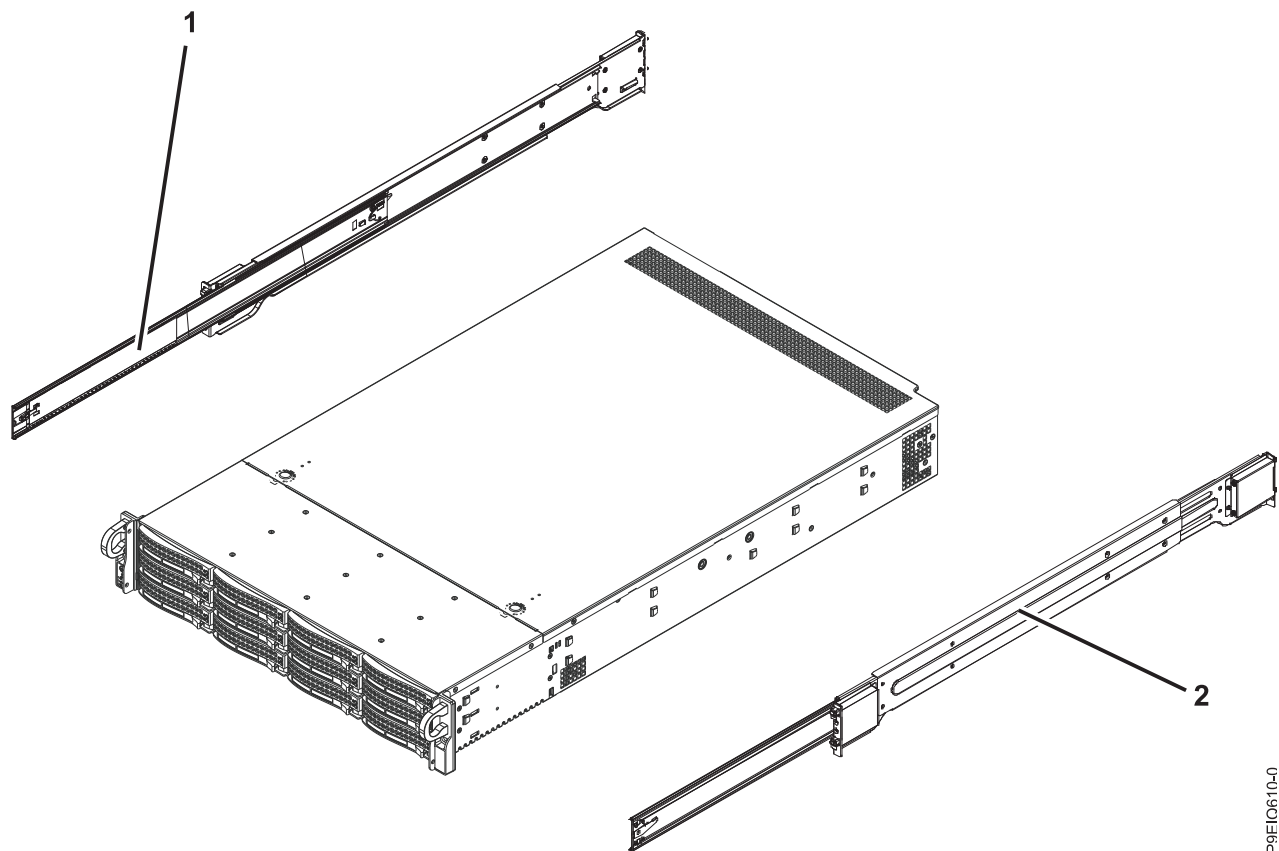
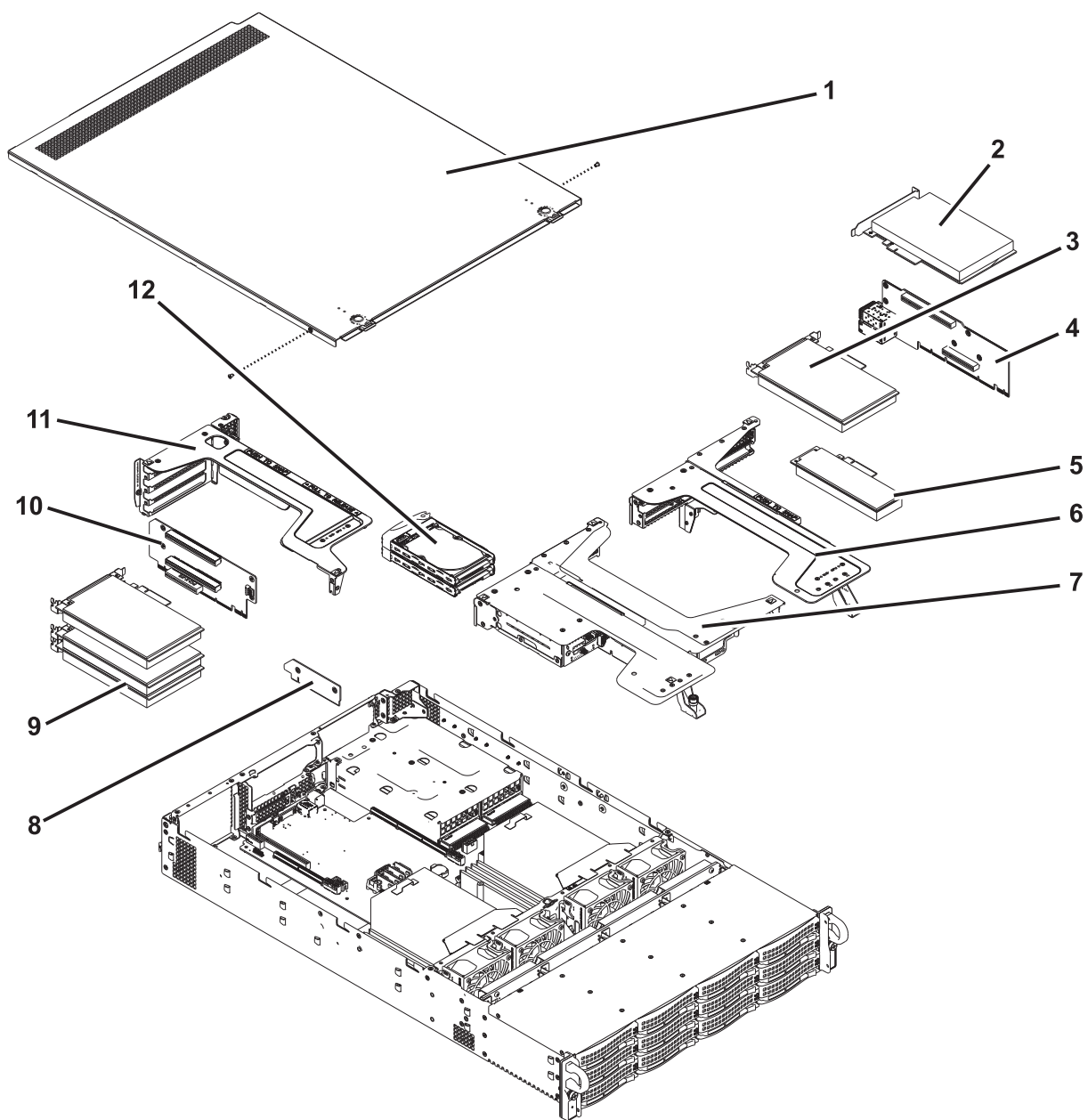


図 1. ラック最終アセンブリー



P9EIQ611-5

図 2. システム部品

背面ポート

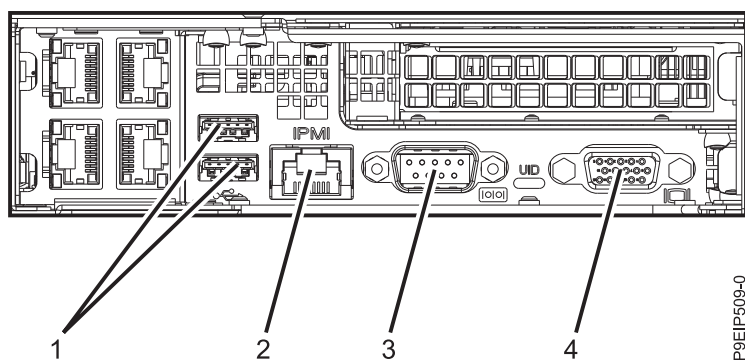


図 3. 背面ポート

表 1. 入出力ポート

ID	説明
1	USB 2.0 (キーボードとマウスに使用)。 一部の USB ドライブは、幅が広すぎてシステム背面の USB ポートに正しく収まらない場合があります。先に進む前に、USB ドライブが適合しているかどうかテストしてください。
2	Ethernet Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
3	Serial IPMI
4	Video Graphics Array (VGA) (モニターに使用)。1024 x 768、60 Hz VGA 設定のみがサポートされます。最大 3 メートルのケーブルのみがサポートされます。テキスト・ベースの機能のみがサポートされます。

取り付けと取り外し

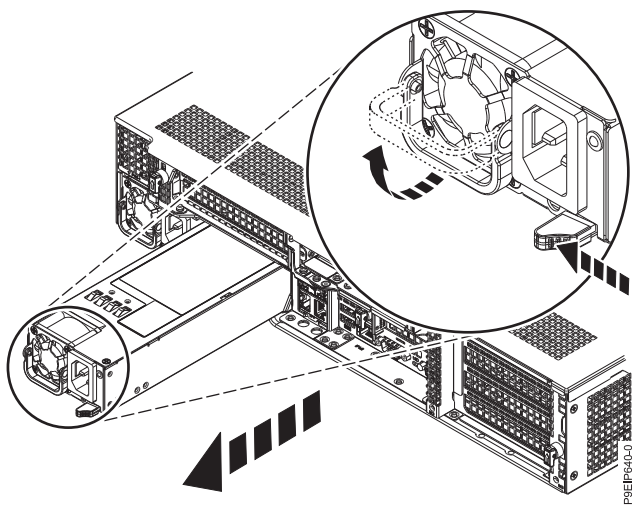


図 4. システムから電源装置を取り外す

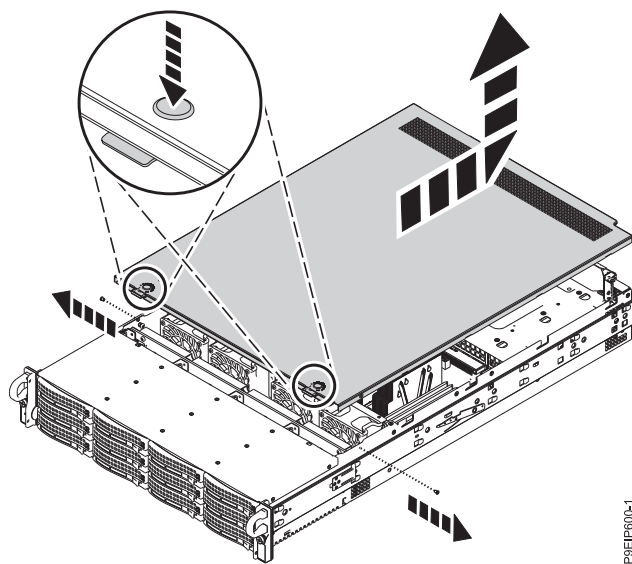


図 5. カバーを解放して開く

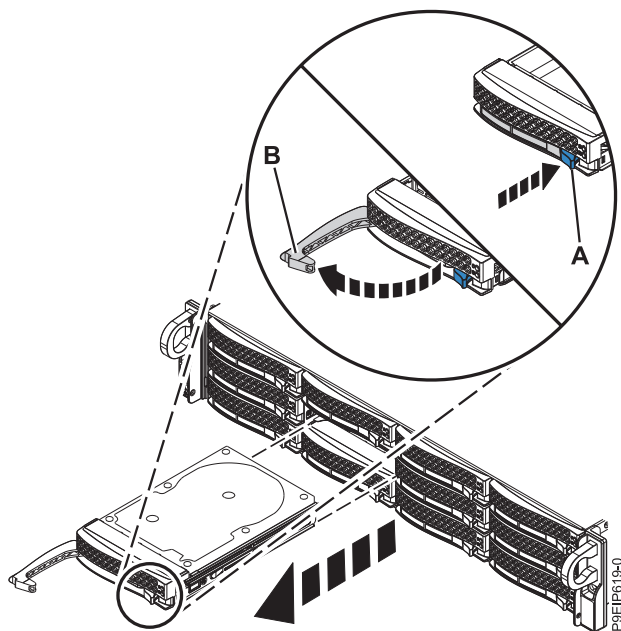


図 6. 前面ドライブの取り外し

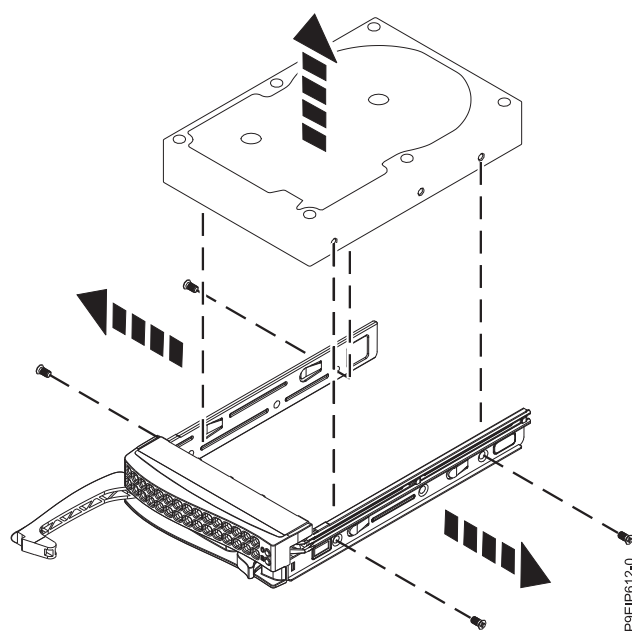


図 7. トレイからの 3.5 型ドライブの取り外し

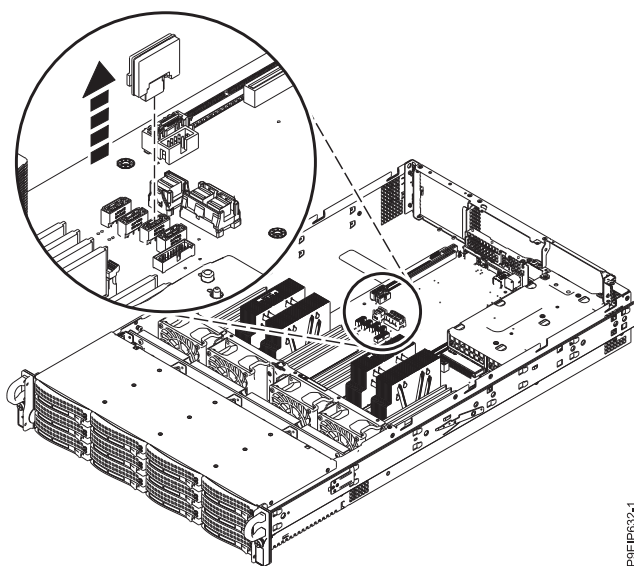


図 8. DOM の取り外し

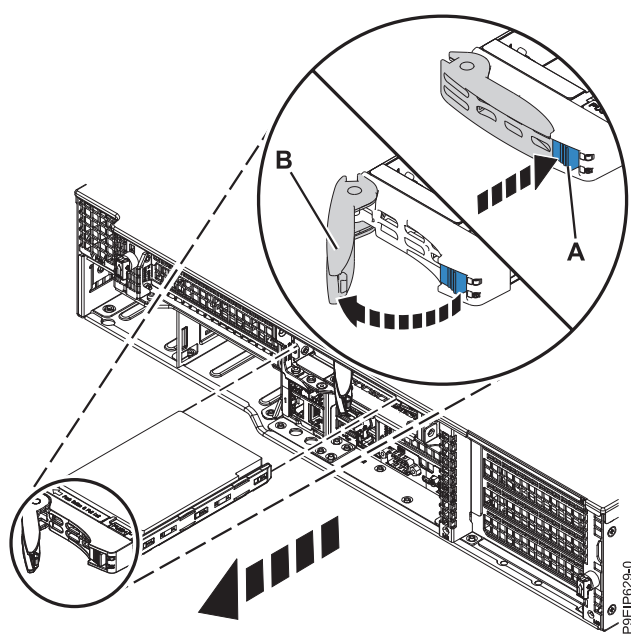


図 9. 背面ドライブの取り外し

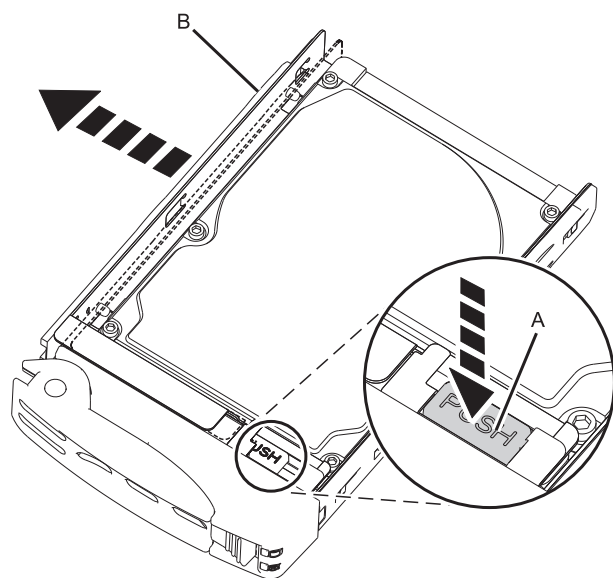


図 10. 背面ドライブ・トレイのオープン

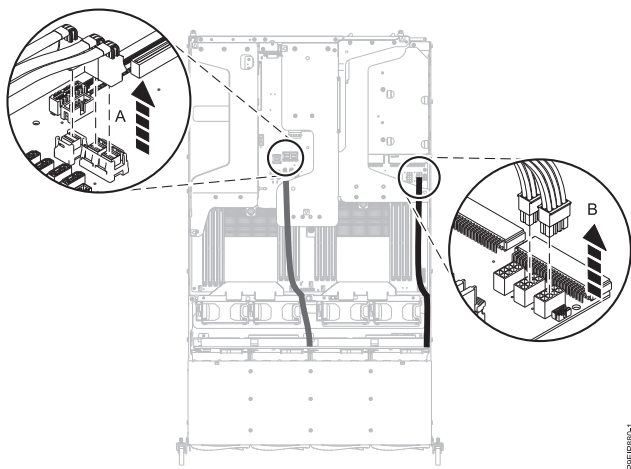


図 11. ドライブの信号ケーブルと電源ケーブルの切り離し

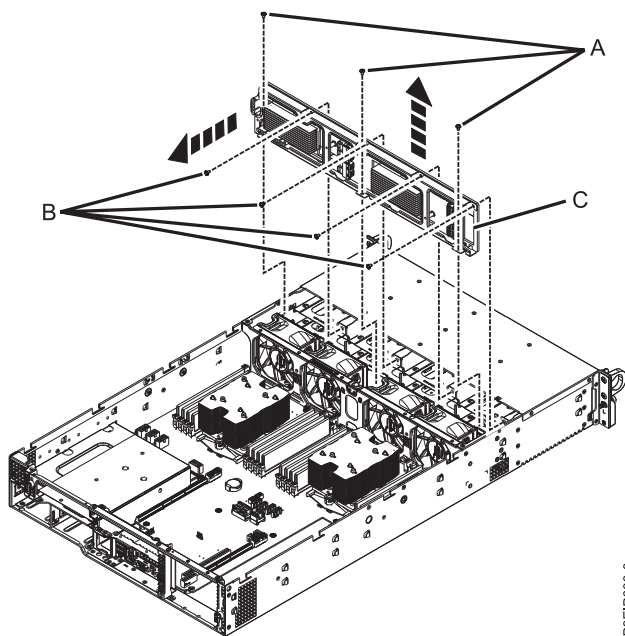


図 12. ディスク・ドライブ・バックプレーンとねじの取り外し

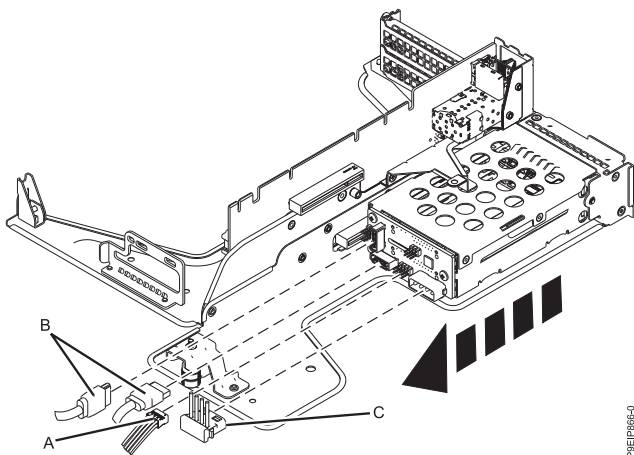
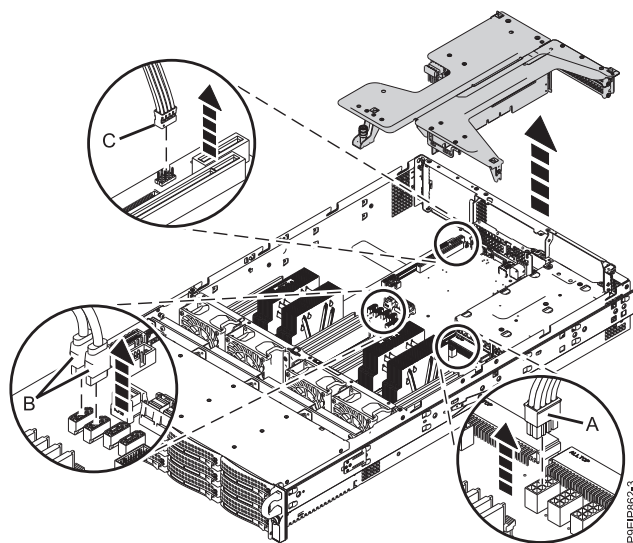
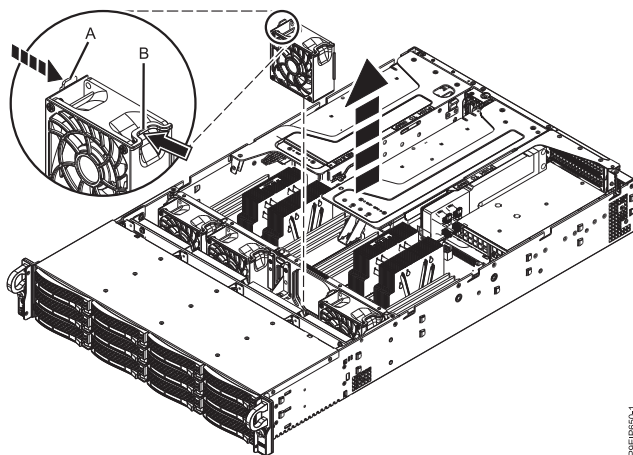


図 14. ディスク・ドライブ・バックプレーンからのドライブの信号ケーブルと電源ケーブルの切り離し



P9EIP638-0

図 13. システム・バックプレーンからのドライブ信号ケーブルおよびドライブ電源ケーブルの切り離し



P9EIP66-0

図 15. ファンの取り外し

P9EIP650-1

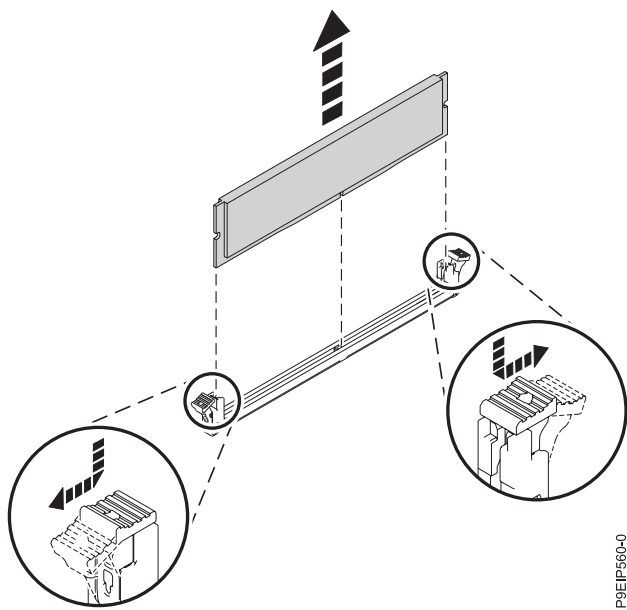


図 16. メモリー DIMM の取り外し

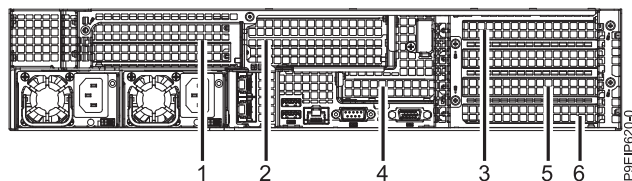


図 18. 9006-22P PCIe アダプターの位置

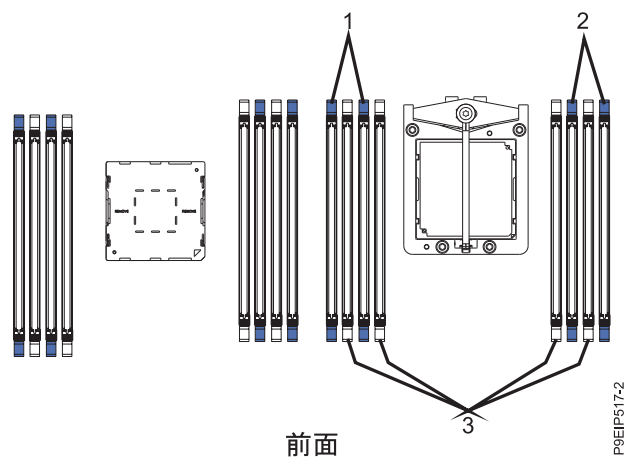


図 17. シングル・プロセッサの差し込み順序

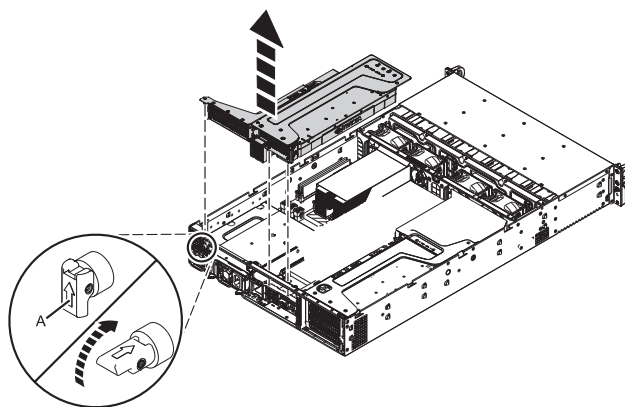


図 19. PCIe ライザーの取り外し

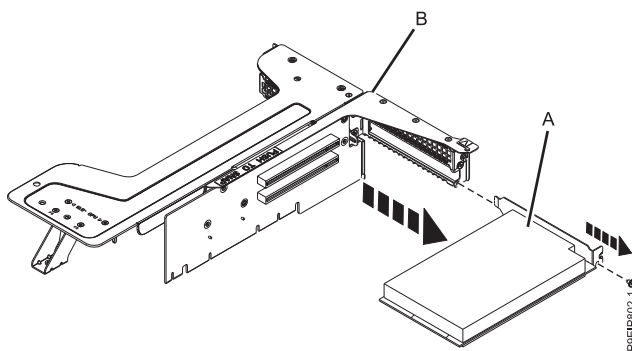


図 20. ライザーからの位置 1 のアダプターの取り外し

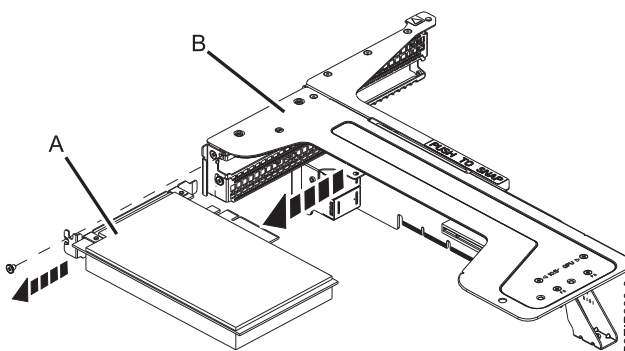


図 21. ライザーからの位置 2 のアダプターの取り外し

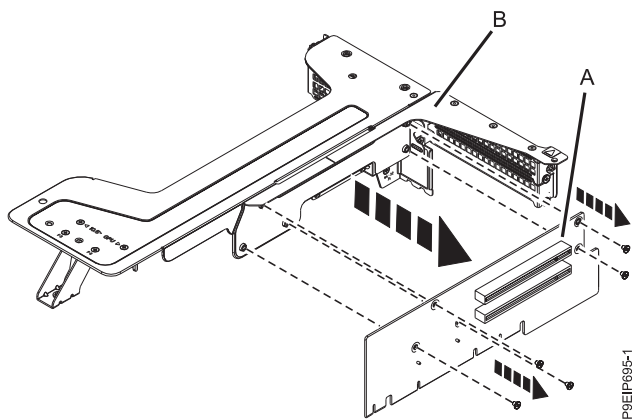


図 22. 位置 1 のライザー・カードの取り外し

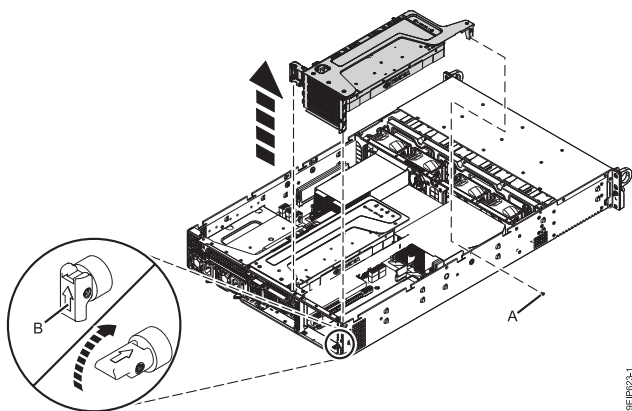


図 23. PCIe ライザーの取り外し

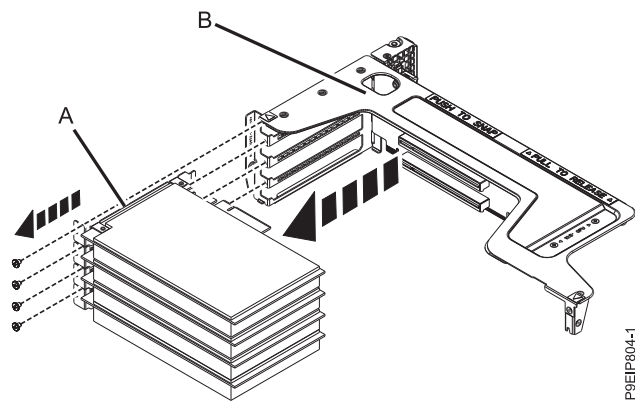


図 24. ライザーからのアダプターの取り外し

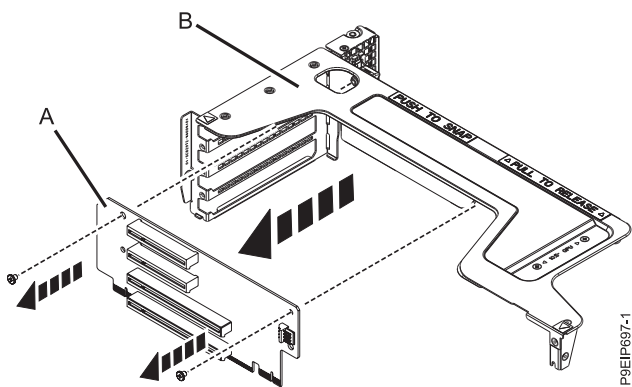


図 25. 位置 3、5、または 6 のライザー・カードの取り外し

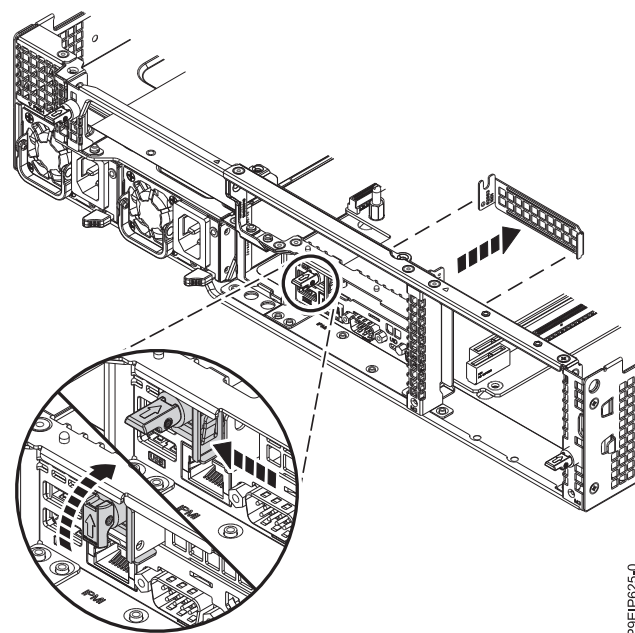


図 26. テール・ストックのリリース

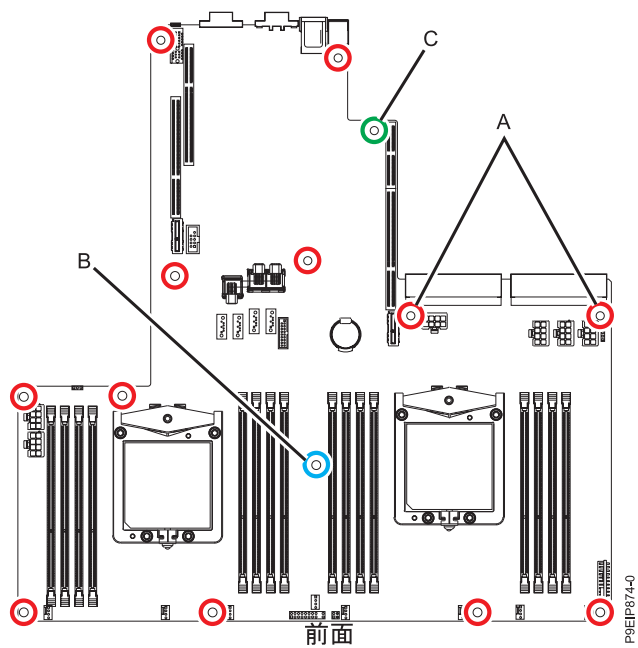


図 27. ねじの位置

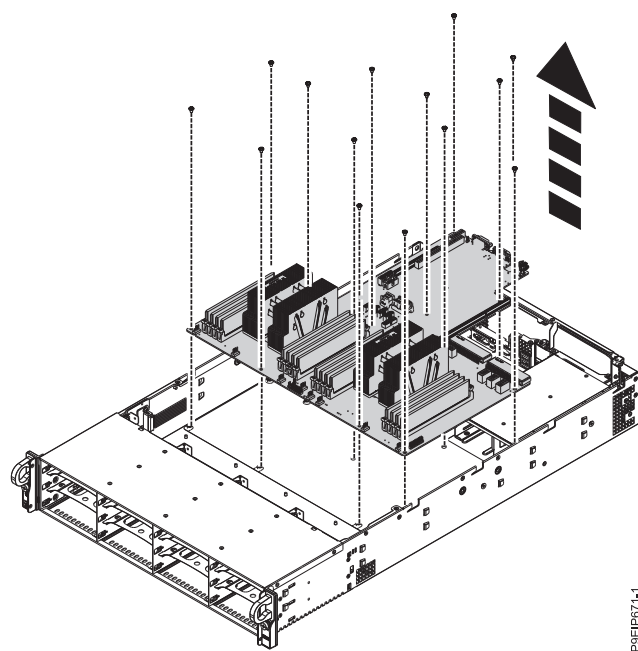


図 28. システム・バックプレーンを持ち上げて外す

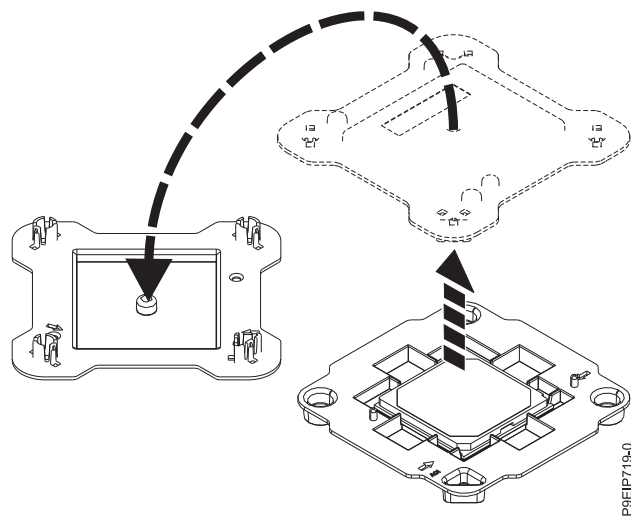


図 29. システム・プロセッサ・モジュールのパッケージを開く

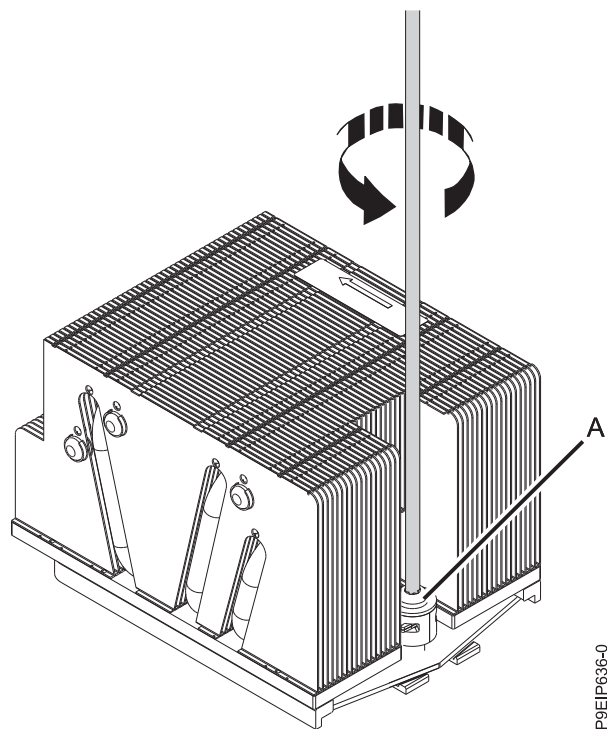


図 30. ヒート・シンクのロード・アームねじを緩める

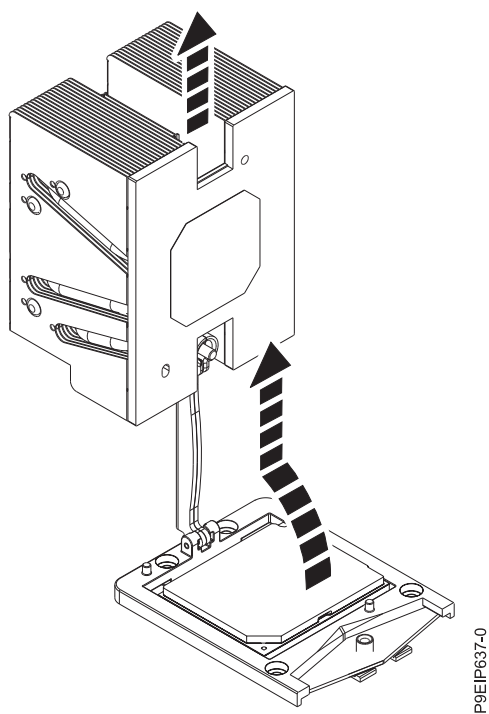


図 31. ロード・アームからヒート・シンクを持ち上げる

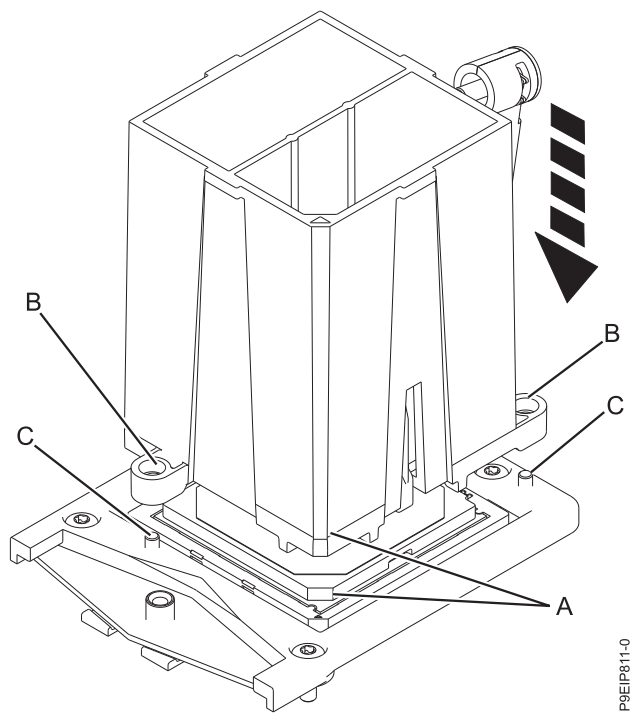


図 32. 取り外しツールをシステム・プロセッサ・モジュールの上に下ろす

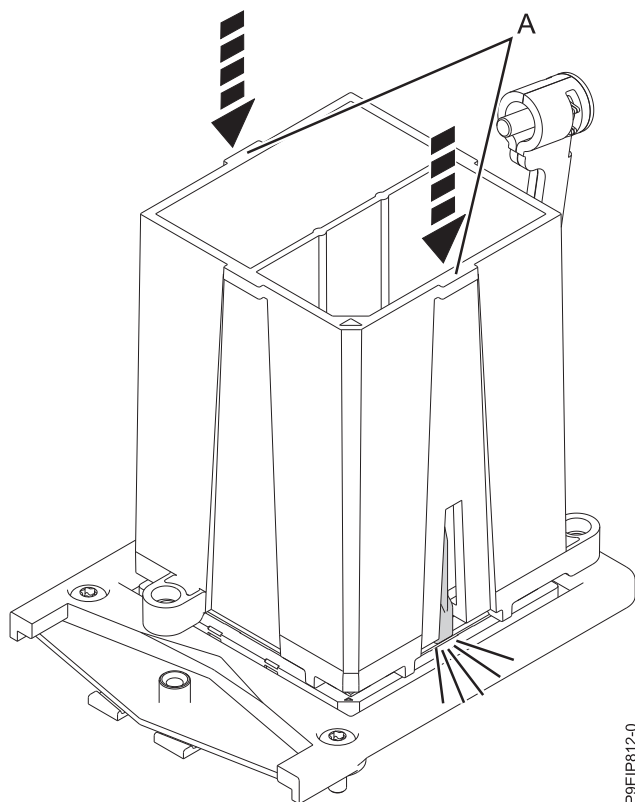


図 33. システム・プロセッサ・モジュールをツールにロック

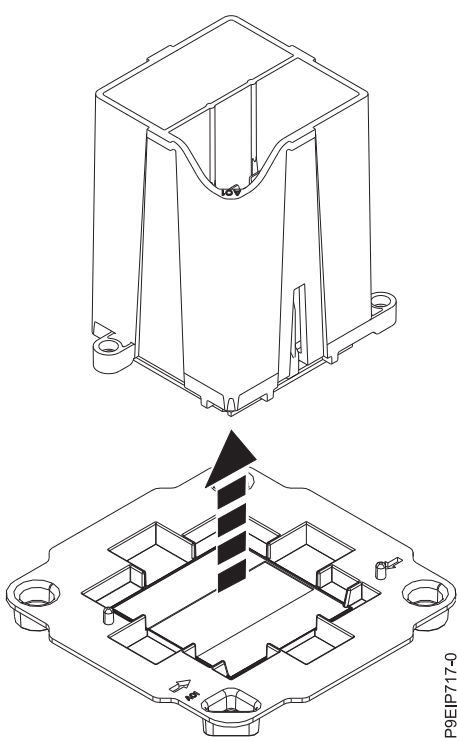


図 34. パッケージ・トレイからのシステム・プロセッサ・モジュールの持ち上げ

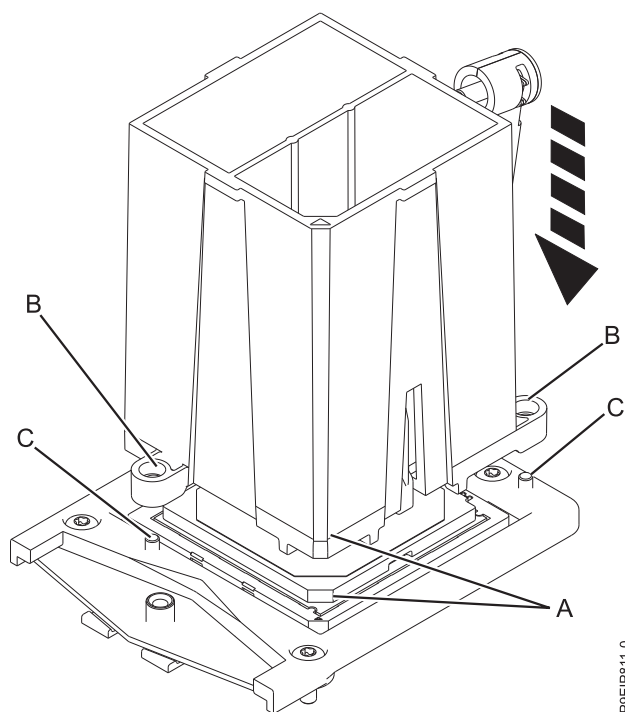


図 35. システム・プロセッサ・モジュールの取り付け

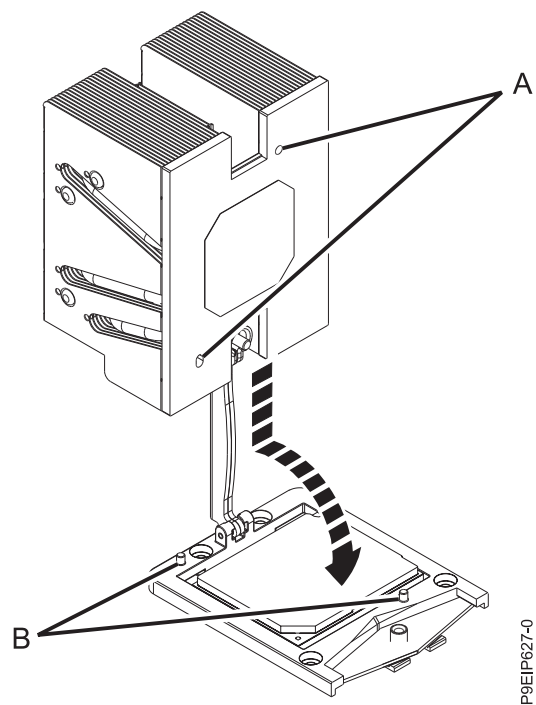


図 36. ヒート・シンクの取り付け

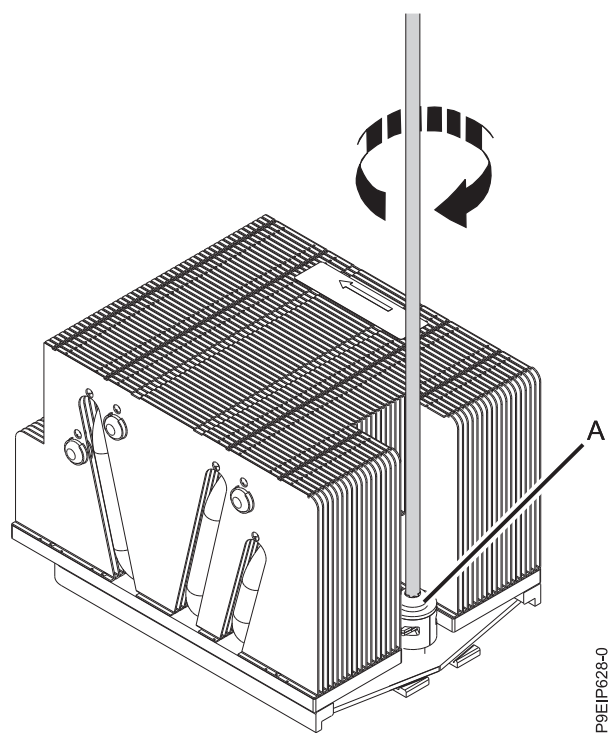


図 37. ロード・アームのねじを締める

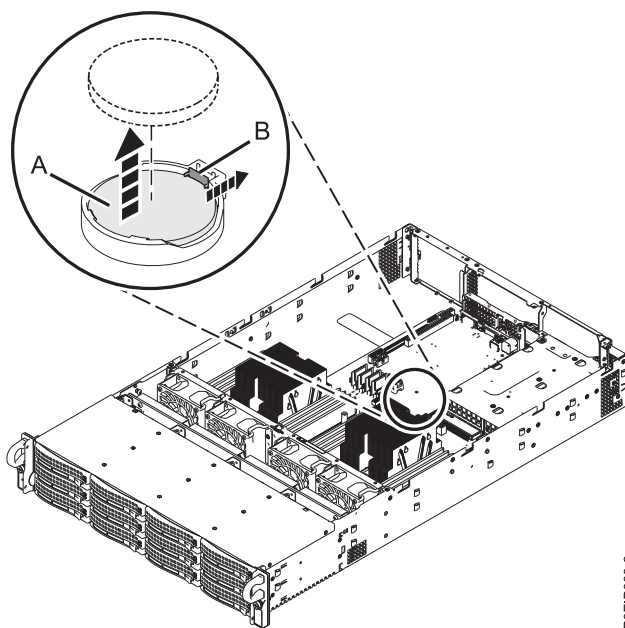
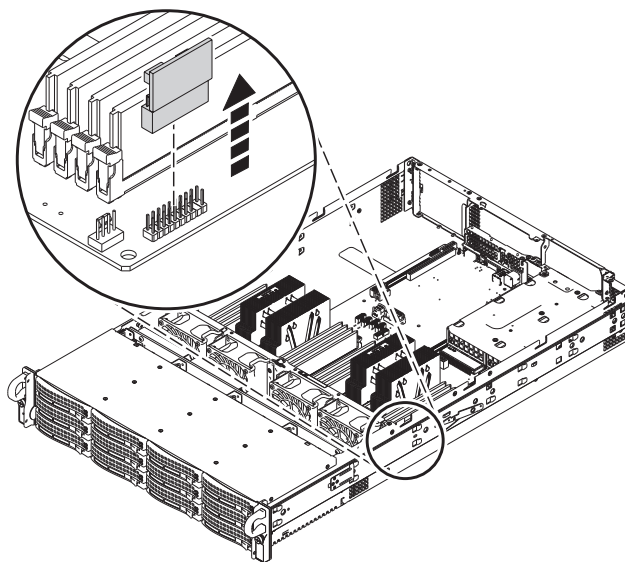


図 38. 時刻バッテリーの位置



P9EIP686-2

図 39. TPM カードの取り外し

P8EIP605-1

2018年7月30日本書は、POWER9™ プロセッサを搭載した IBM Power Systems™ サーバーおよびすべての関連モデルに適用されます。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

© Copyright IBM Corporation 2018.